

PCB 报价单

收件公司 (To) : 博泰车联网科技 (上海) 股份有限公司		发件公司 (From) :			
收件人 (Attn):		发件人 (From):	电话号码 (Phone):		
邮箱地址 (E-mail):		邮箱地址 (E-mail):			
电话号码 (Phone):		文件编号 (No.):	页数 (Pages):		
传真号码 (Fax):		日期 (Date):			
单片价格明细 (Price list):		报价有效期 (Valid date):	VAT (含税): 否		
层数 (PCB Layer Numbers) : 博泰料号 (PATEO PN):		PCB总数量:	总价:		
<input type="checkbox"/> 1 Layer <input type="checkbox"/> 2 Layers <input type="checkbox"/> 4Layers <input type="checkbox"/> 6Layers <input type="checkbox"/> 8 Layers <input type="checkbox"/> 10 Layers <input type="checkbox"/> 12 Layers <input type="checkbox"/> HDI <input type="checkbox"/> Others:					
序号	项目	工序	各流程成本金额 (未税)	所占总价格的百分比率	备注
1	材料成本	板材 品牌型号/规格 (SY/NY/GP) <input type="checkbox"/> FR4 <input type="checkbox"/> FR4 High TG (Tg>150) <input type="checkbox"/> FR4 High TG (Tg>170) CTI:			说明: 1、此表符合单双面多层板的生产流程, 若是设计要求不能满足的可在其中增加生产流程; 2、若是HDI 板或者2/3阶, 或者任意阶请按照HDI生产流程增加相应工序;
		PP 品牌型号/规格 (SY/NY/GP)			
		铜箔 品牌型号/规格			
2	制造成本	CAD_1 [工程设计]			
3		CUT[开料]			
4		WIFD[内层线路、蚀刻、AOI]			
5		EMPP[层压]			
6		DRI1[一次钻孔]			
7		PTH[沉铜电铜、整板电镀]			
8		WFD[外层线路]			
9		PP[线路电镀]			
10		OE[蚀刻、AOI、阻抗检测]			
11		WFS[阻焊]			
12		SSCM[丝印字符]			
13		Suface treatment [表面处理]			
14		E-T 四线测试			
15		MM[铣边]&V_CUT1[V槽1]			
16			人工成本		
17		正常利润			
		总价合计:			